



令和5年5月22日

広島大学が日米半導体連携パートナーシップに参画

情報提供

広島大学は、マイクロン社¹とのパートナーシップに基づく日米半導体連携「UPWARDS for the Future²」に参画し、半導体の研究開発を強化するとともに、人材養成の拠点を形成し、日本を牽引してまいります。

日米半導体連携のパートナーシップに参画するのは、日本側が広島大学、東北大学、東京工業大学、名古屋大学、九州大学、米国側が、パデュー大学、ボイシ州立大学、ワシントン大学、ロチェスター工科大学、レンセラー工科大学、バージニア工科大学の日米合わせて11大学です。

5月21日、広島市内において、エマニュエル駐日米国大使立ち合いの下、永岡文部科学大臣、プリンケン米国国務長官と各大学長による覚書（MOU）の締結式が行われ、日本から広島大学の越智学長と東北大学の野野山学長、米国からはパデュー大学のチェン学長、ボイシ州立大学のトロンプ学長が代表として参加。その後に行われたプレスカンファレンスには、G7 広島サミットで来広したバイデン大統領も同席しました。

本パートナーシップは、多様な半導体人材養成を力強く推進し、半導体関連の研究開発を振興することを目的としています。広島大学など11の参画大学は、先進的なカリキュラムに加え、多様性、平等性、包摂性などが高く評価されて選ばれたものです。

今後、日米における新たな交流プログラムを実施し、半導体分野での女性活躍を促進しながら、多様性に富む人材を教育し、半導体開発に積極的に取り組んでまいります。

広島大学は、半導体教育研究拠点として国内の国立大学で最も長い歴史を育んできました。本年4月には産官学で半導体開発に取り組む「せとうち半導体共創コンソーシアム」の拠点を東広島キャンパスに開設するなど、半導体の研究開発を重要な戦略事業の柱と位置付けています。世界最先端となるマイクロン社広島工場と連携して、日米の半導体技術の多様化・高度化と人材養成に一層貢献してまいります。

【お問い合わせ先】

広島大学総合戦略室 小松崎
Tel : 082-424-6052 FAX : 082-424-6007
E-mail : u-strategy-gl@office.hiroshima-u.ac.jp

発信枚数：A4版 1枚（本票含む）



¹ マイクロン社は東広島に日本本社が所在する半導体メモリーのリーディングカンパニーであり、過去5年間において最大の対日直接投資を実施する企業。

² U.S.-Japan University Partnership for Workforce Advancement and Research & Development in Semiconductors for the Future